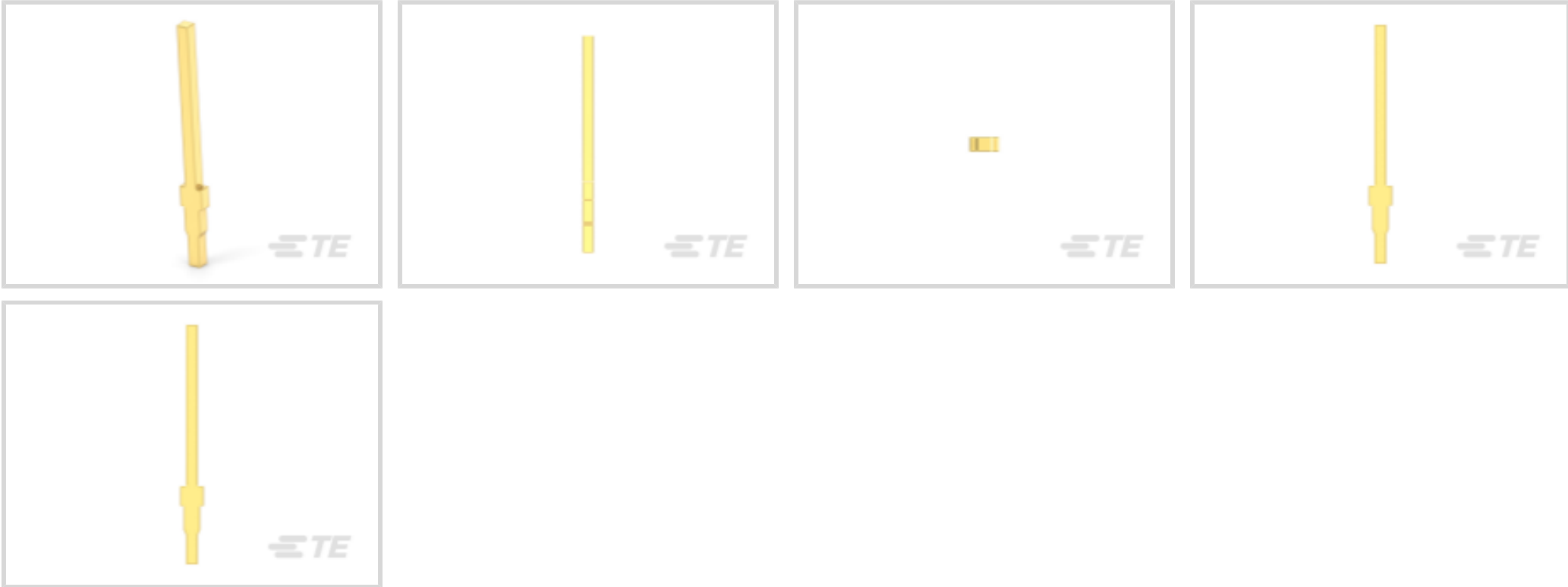




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 柱体

连接器系统: 板对板

端子接触部电镀材料: 金

端子方向: 直式

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

接触件特性

端子接触部长度	8.63 mm[.34 in]
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子基材	黄铜
端子类型	柱体
端子接触部电镀材料	金
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

接合入口位置	顶部
--------	----

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.06 in]
------------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 100 °C[-85 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



文档

产品图纸

MOD II POST PLTD 50 AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87307-3_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87307-3_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-87307-3_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

AMPMODU Mod I And II Posts

英文版本

应用规格

日语

AMPMODU Mod I And II Posts

日语

应用规格

英文版本